

广东通宇通讯股份有限公司 关于产业基金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司、宁波梅山保税港区恒明方圆投资管理中心（有限合伙）、吴中林先生设立“樟树市鸿运金鼎投资管理中心（有限合伙）”。该产业投资基金聚焦于通信全产业链的并购与投资，投资（含发起设立）在中华人民共和国注册，或其运营主体及其经营的主要业务在中华人民共和国境内的优质通信产业链企业，推进公司快速完成产业链布局，打造产业生态，提高公司在产业领域内的市场地位。

基金的组织形式为有限合伙企业，基金规模为10亿元人民币，公司、吴中林先生作为基金的有限合伙人向基金出资，基金首期规模2亿元，其中公司出资募集规模的40%，吴中林出资募集规模的20%，该议案已于2017年3月23日第二次临时股东大会审议表决通过。

基金已于2017年8月29日在樟树市市场和质量监督管理局办理了营业执照登记。

近日，樟树市鸿运金鼎投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鸿运金鼎”）与湖南格兰德芯微电子有限公司（以下简称“格兰德芯”）及其新老股东共同签署了《湖南格兰德芯微电子有限公司投资协议》（以下简称“投资协议”）。鸿运金鼎出资1,500万元人民币与其他投资方合计出资15,000万元人民币认购格兰德芯新增注册资本1,213.8458万元，余额13,786.1542万元计入格兰德芯资本公积，其中鸿运金鼎占本次增资完成后格兰德芯注册资本1.42857%，具体情况如下：

一、标的公司的基本情况

名称：湖南格兰德芯微电子有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 D 研发厂房

法定代表人：彭宇红

注册资本：7,283.075 万人民币

成立日期：2015 年 08 月 11 日

经营范围：通信技术开发，信息系统集成服务，通信设备、集成电路、电子元件、计算机软件的开发、设计、生产、销售及进出口以及相关技术的咨询、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、投资标的的经营情况

格兰德芯主要从事射频前端器件的芯片设计，具有高性能 GaAs 及硅体 CMOS 射频前端设计技术，全球领先推出纯硅体 CMOS 工艺高功率、高线性、宽频全集成功放及射频前端 IC，具备在纯硅体 CMOS 工艺上设计生产出高性能射频高功率产品。其产品可广泛应用在 WIFI（路由器/手机）、5G 设备、物联网设备等多个领域，目前是国内较早实现 WiFi5 产品量产、实现 WiFi6/5G NR 微基站 PA 量产并得到主流 SOC 合作厂商的企业。

三、投资协议的主要内容

鸿运金鼎出资 1,500 万元人民币认购格兰德芯新增注册资本 121.3846 万元，取得投资后格兰德芯 1.42857% 的股权，其中 121.3846 万元计入公司的新增注册资本，其余 1,378.6154 万元作为格兰德芯的资本公积金。

四、对上市公司的影响

1、根据公司的战略规划，公司除加强在基站天线端的战略布局外，积极寻求外延式投资机会，产业基金投资格兰德芯，有助于公司在芯片领域的布局，推动公司完成通信全产业链布局，同时有助于提高资金使用效率，加强公司投资能力，为公司整体战略目标的实现提供支持。

2、本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，不会对公司的财务及经营状况带来重大影响，不存在损害上市

公司及股东利益的情形。

五、风险提示和其他说明

本次对外投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日